

美日半导体谈判

谈判背景：

20 世纪 80 年代初期，美国政府开始着手处理美国市场上不断增强的来自日本产业竞争的问题，以及美国产业界要求美国政府采取行动实施对产业的保护的呼吁。美国政府希望日本方面能主动限制对美国的出口，这种自愿限制出口措施曾被日本用于销往美国的钢铁和汽车等产品上。同时美国人还不断地寻求使美国产品进入日本市场的办法，因为美国人认为日本市场是一个封闭的市场。美国与日本的贸易长期处于逆差状态，这使国会缩减贸易赤字的努力不断受挫，这种挫折感在美国与日本的半导体谈判期间达到了高峰。日本人在贸易领域对美国形成的威胁成为共和党人可以大做文章的事件，因为里根政府能利用这一事件宣扬它的“自由”和“公平”的贸易思想，并且借此采用更为强硬的措施向日本人施加压力随着美国方面的压力和指责不断升级，日本方面感到愤愤不平，但同时也越来越对美国方面的保护主义情绪表示关注，因为这种情绪有可能影响日本产品进入有利可图的美国市场。日本人还希望避免在国际上被贴上“不公平的贸易伙伴”的标签。

到 20 世纪 80 年代中期，日本在美国半导体市场所占有的份额已经超过了美国在日本半导体市场所占有的份额，而且日本供应商在全世界的市场份额正逐渐超过美国。美国人指控日本芯片制造商以低于公平市场价格的价格在美国市场倾销半导体，并且指控日本不准许外国制造商进入其国内市场。这两桩事件有着重要的联系。首先，美国产业界把日本的市场准入状况视为日本半导体产品在美国市场竞争力强弱的决定因素。受到保护的日本国内市场使日本芯片生产商能够保持低廉的生产成本，从而削弱了美国制造商的市场竞争力。其次，除了可以使用 301 条款进行贸易报复以外，几起针对日本半导体销售商的反倾销案为美国在与日本进行市场准入状况的谈判中提供了可以借用的手段。

对于日本人来说，谈判中的主要问题是如何阻止美国把日本说成不公平的贸易伙伴并对其实施贸易制裁和征收反倾销关税，同时保护半导体产业的竞争力，因为该产业对于日本未来经济的发展起着举足轻重的作用

1984--1989 年美日半导体产品在彼此国家所占份额以及在世界市场上的份额 (%)

	1984	1985	1986	1987	1988	1989
美国在日本的份额	11.2	8.5	8.6	9.6	10.2	11.0
日本在美国的份额	14.3	11	13.9	16.6	24.3	26.6
美国在世界市场的份额	53.6	48.9	42.4	40.9	37.4	37.3
日本在世界市场的份额	36.9	41.2	46.0	47.7	51.2	50.4

资料来源：美国半导体产业协会

美国方面的谈判准备

美国商务部及美国贸易代表是谈判的主角，但在他们之间有不同的分工。美国贸易代表主要负责解决日本市场准入状况的争端问题，而商务部则主要负责解决日本在美国市场的倾销问题。美国国务院也被卷入到有关的谈判中。尽管国务院内部存在着一些抵制意见，而且有些部门对谈判中达成协议的方式并不完全满意，但国务院总的来说是支持商务部和贸易代表的

国务院最终给予支持的一个关键因素是美国半导体产业早些时候曾经使国务卿舒尔茨相信日本只是美国芯片产品的一个很小的市场，这与世界其他市场相比是不正常的现象。另一个因素是国务院的特别谈判代表的作用，他不但熟识政府其他部门的谈判代表和半导体产业的说客，并且与他们相处得很好。此外，对舒尔茨及参与谈判的国务院人员来说还有政治压力：他们认为国务院需要在国会及行政部门中建立起信任感，一个办法就是扩展对美国利益范围的定义，即美国利益不仅包括政治与安全方面的利益而且包括更广泛的经济利益。

白宫更倾向于关注美日经济冲突所导致的两国间的政治关系问题，但是这一拒心由于半导体产业对美国国家利益的重要性而被抵消了。

美国各方面的态度能够相对统一的一个主要原因是半导体产业的影响。半导体产业协会(SIA, 由 50 多个主要芯片制造商组成)成立于 20 世纪 70 年代后期，它公开地应对日本的挑战。半导体产业协会和其他独立的芯片制造商是谈判的主要发起者和催化剂它们游说美国政府对日本人发起反倾销调查，指控日本人的不公平贸易行为，并且为反倾销和谈判提供了主要的支持。

然而，半导体产业和一般的微电子产业在这些问题上意见并不一致。为此，半导体产业协会及早采取行动并较好地统一了产业内部各种不同的意见。半导体产业协会动员各个产业部门为了使大家都获益的共同目标而努力，即占领更多的日本市场。有些公司如 IBM 等之前对采取贸易行动并不热情，后来也同意不干涉半导体产业协会而让协会去采取行动。美国电子协会是用户的代表，它早在 1985 年就得知了主要的情况，而且此后凡是在需要的时候半导体产业协会还经常向它进行更为详细的咨询。在任何情况下用户之间都很难形成统一的看法，而且与半导体产业协会相比，美国电子协会在华盛顿的影响力要小得多。

在半导体一案的谈判过程中，反倾销诉讼在美国的政治方面起着主要作用，发挥着国内及国际功能。在国内，一旦反倾销诉讼被立案，日本以不公平方式渗入美国市场的问题便会正式与美国进入日本市场的问题相联系。再者，反倾销诉讼给予了那些希望对日本采取强硬立场的人以法律权力。从另一个结果考虑，如果谈判未能达成协议，而反倾销诉讼获胜，美国市场的芯片价格将会上涨，结果会使美国市场无法与世界其他市场竞争。因此美国方面有更大的动力通过谈判达成一项协议，而不是仅仅在反倾销诉讼中获胜，取得对日本倾销行为的处罚。美方可以借用反倾销诉讼使美国在谈判中拥有更强的讨价还价能力，规划安排与日方的谈判，同时它还有助于使美国国内各方在谈判战略和协议的价值上达成一致意见。

美方的谈判条件

由于半导体产业协会提前为内部达成有效的一致意见所做的努力，以及反倾销诉讼的作用，美国参与谈判的各主要方面所提出的与日方谈判的条件都非常接近。各方在日本的市场准入状况必须与美国的市场保护目标相联系这一点上的一致，以及由此所形成的利益的广泛结合，最终成为美国的一揽子谈判条件和谈判战略

以及国际谈判动力的基石。

美方认为为了获得美方主要谈判人员的批准和认可，以下几点要求应当包括在谈判的条件内。

(1) 日本政府必须尽一切努力排除阻碍美国实质性增加在日本半导体市场上的份额的障碍。美国期望在短期内使美国公司在日本市场上的份额至少增加一倍。多年来，美国公司一直只占有日本市场的 8%~10%的份额。以往的研究表明，如果日本的市场不存在贸易壁垒，美国的市场份额应当在 30%以上。因此 30%就成为美方谈判的一个起始要价，当然，低于 30%的份额也可能获得谈判各方的批准，但是可能获得批准的底线不应低于 20%

(2) 所有在美国市场进行销售活动的日本公司，如果有倾销芯片行为的，都必须终止倾销，而且为达到这一目的，美国应建立起一种监督机制。在美国市场上，所有在美国以低于生产成本或公平市场价格的价格出售芯片的日本公司都应该停止销售此处的关键词是“所有”公司。参与谈判的各主要方面都同意，任何一项允许日本公司继续倾销的决定都不会充分地保护美国公司。这样，在监督倾销是否发生时，使用平均定价方法是不可接受的，因为只要其他公司以高于平均价格出售，这项决定就会使一些日本公司继续进行倾销。

(3) 必须制止日本公司在日本和第三国倾销芯片的行为，而且为达到此目的应建立起相应的监督机制。美国政府和产业界的主要谈判代表同意：任何条约都必须涉及在其他国家销售片的问题，以免任何禁止日本公司在美国倾销的协议由于日本公司在日本和第三国的低价销售而被破坏，因为终端用户可以到这些国家去购买它们所需要的芯片。

(4) 目前正在进行的反倾销诉讼可能不得不暂时搁置起来，但不是终止调查。终止调查会削弱美国阻止日方违反谈判可能达成的协议的力量。单纯的搁置(以换取一项符合上述目的的协议)可以使美方在必要的时候尽快重新提起对日方倾销的诉讼。

半导体产业协会把日本市场准入状况和解决日本对美国的市場渗透的问题联系在一起的做法既使美国的一揽子谈判条件更具体化，又将其控制在一个狭小的范围。如果谈判的协议不包括所有这些要求在内的话，谈判主角们就不会认可这个协议。

日本方面的谈判准备

通商产业省是日本官方的谈判主角。通商产业省由于它的“有管理的产业和贸易政策”和为产业提供“行政指导”而闻名。例如，它曾经在 20 世纪 80 年代初不顾一些日本汽车公司的反对，成功地实施了对汽车出口的“自愿限制出口”措施。后来，由于日本工业日益壮大并且越来越国际化，通商产业省对某些产业(半导体产业就是一个主要的例子)的强制性作用已经减弱了。在此次谈判中如果通商产业省能同美国达成一项协议，这将会赋予它新的权力和机制来控制芯片制造商，从而使它在工业部门重新建立自己的影响。

正像日本许多其他产业一样，日本的半导体产业基本上属于寡头垄断行业，即只有少数几家大公司一大约 10 家芯片生产厂家，其中不少是较大的、经营多种电器的公司(如日立、东芝、NEC 等)。与更加分散的美国公司形成对照的是，这些日本大公司以相对纵向的方式组合，它们既是面向终端用户的计算机生产商，同时又是芯片生产商。日本半导体产业非常关心的是，日方如果不能执行谈判达成的协议，可能会遭到美国的反倾销诉讼及其他报复性措施。但许多公司宁愿不

达成协议，而是去适应美国的关税调整，因为如果达成协议，通商产业省不仅会在国内和国外对价格实行控制，而且会要求日本厂商向美国政府透露专有的生产成本信息，它们担心美国政府会把这些信息泄露给它们的美国竞争者。

半导体产业内部存在一定程度的意见分歧，因为并非所有的公司都被列入反倾销调查案名单中，那些没有被列入上述名单中的公司不会因为没有达成协议而遭受处罚。再者，有些公司在是否达成协议上有更大的利益关系，因为它们生产的许多其他电器消费品也可能成为美国制裁的对象

正像在与美国的其他贸易争端中一样，日本首相的威信与他解决争端的能力紧密地联系在一起。在半导体案件中，这就意味着首相和自由民主党的领导们与官僚机构通商产业省联合在一起共同解决这一贸易争端，同时避免美国的报复。可见在政府与产业界之间也存在着冲突。

日本的谈判条件

由于政府与产业界之间以及产业界内部存在根本分歧，日本的一揽子谈判条件受到严格制约—不具体，包括的内容广泛，而且在关键问题上与美国的一揽子谈判条件的要求相去甚远。日方可能接受的协议必须包括：

(1) 终止或至少是搁置反倾销案件和悬而未决的 301 条款案件。

(2) 避免美国的报复

(3) 将在美国市场上的份额限制在可以避免报复的范围内。美方提出的 20% 或更多的份额不可能得到产业界的同意。而将美国在日本的市场份额提高几个百分点，达到百分之十几，可能会得到日方同意。

(4) 避免建立涉及第三国或者强迫日本公司向美国政府提供专有信息的监督体系。在这里，通商产业省与产业界的接受条件有所不同：通商产业省能够接受建立涉及第二国或者向美国政府提供专有信息的监督体系。然而尽管增加了适当的保护措施以防止信息被泄露给美国公司，半导体产业界中的许多公司仍然不可能同意带有这些条款的协议。